

【特徴】 不必要な部分に金めっきされた状態の欠陥

【特征】 在不必要部位镀上金的缺陷。

【Characteristics】 Gold plating is made on an unnecessary area.

【原因・判断ポイント・発生工程】 誤ったソルダレジストパターンが形成されたり、レジストに傷が出来たために出来たもの（ソルダレジスト形成工程、ソルダレジスト形成工程後）

【原因、判断要点、发生工序】 因为错误，形成了阻焊剂图形，或者阻焊剂受伤所引起的（形成阻焊剂工序、形成阻焊剂工程后）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
The defect is caused by a wrong solder resist pattern or a scratched solder resist (Solder resist application and after the application)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
チェッカープローブ傷跡に金めっきが付着
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
探测针的针迹伤及镀金层
显微镜倍率 ×

【Comments】
Open portion by Gold is attached on the contact impression from a checker probe.
Magnification: ×

4-3 はんだコーティング (HAL) 欠陥／ 热风整平 (HAL) 的缺陷 / Solder coating (HAL) defects

4-3-1 はんだ組成異常起因／焊料成分的异常 / Caused by improper solder composition.

4-3-1-1 はんだ盛り上がり過多／焊料隆起太多 / Excessive solder mound

【特徴】 はんだコーティングが蒲鉾状に盛り上がっている状態の欠陥

【特征】 焊料层有半圆形鼓起的缺陷。

【Characteristics】 Coated solder rises in a semi-cylindrical shape.

【原因・判断ポイント・発生工程】 はんだの銅含有量などが多過ぎることにより出来たもの（HAL工程）



【コメント】
はんだブリッジと同居している
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
与桥接共存
显微镜倍率 ×

【Comments】
Coexists with a solder bridge
Magnification: ×